

AM/DM37x + WL1271

Wi-Fi®およびBluetooth®プラットフォーム



プラットフォームの特長

- WLAN (IEEE 802.11 b/g/n) およびBluetooth 2.1 +Enhanced Data Rate (EDR) ならびにクラス最高の co-existence (同時動作) テクノロジーをワンチップに統合済みです。
- LS Research社より周辺部品を内蔵し検証、認証済みの量産可能なモジュールWL1271-TiWiをご提供します。
- WL1271-TiWiモジュールはAM/DM37x SWを統合済みです。
- ファームウェアおよびローレベルのドライバを含む機能をシステムに統合してご提供します。
- Enhanced Low Power (ELP) など各種テクノロジーが、スループットおよび消費電力をシステム・レベルで最適化します。
- ハードウェアおよびソフトウェアの試作に役立つ、多機能の評価モジュールを供給します。
- Linux 2.6.x WLANドライバ、WPAサブリカント、オープンOBEX プロファイル、BlueZ Bluetoothを含む SDK (ソフトウェア開発キット) を供給します。
- CLIベースで、WLANおよびBluetoothの各機能を体験できる (説明付き) サンプル・アプリケーションおよびデモンストレーション・プログラムを供給します。
- Getting Started Guide、文書資料およびサポート入手先: www.ti.com/connectivitywiki

プラットフォームの利点

- 実績あるTIの第6世代目のWLANテクノロジーが電子機器間、インターネットおよび有線ネットワーク経由の安全で高いスループット、高い信頼性のWi-Fiコネクティビティ機能を実現することができます。
- TIの第7世代目のBluetoothテクノロジーがパーソナル・エリア・ネットワーク内の各種ローパワー・アプリケーションをサポートします。
- 確実な同時動作性を提供するテクノロジーが、WLANとBluetoothの各コアの間でインテリジェントな協調動作および帯域幅の割当てを実現します。
- ELPテクノロジーが最終製品の電源効率および電池持続時間を向上します。
- モジュールでの提供により、製造コストおよび運用コストの低減、基板実装面積の縮減、認証を簡素化し、RF開発をサポートします。
- ホスト・プロセッサとWLAN/Bluetoothを統合してあることで、製品のハードウェアおよびソフトウェアの開発が簡素化され、市場投入時間の短縮に役立ちます。
- WLANおよびBluetoothの機能を必要とする各種アプリケーションの試作および開発を実現する評価ツールを供給します。

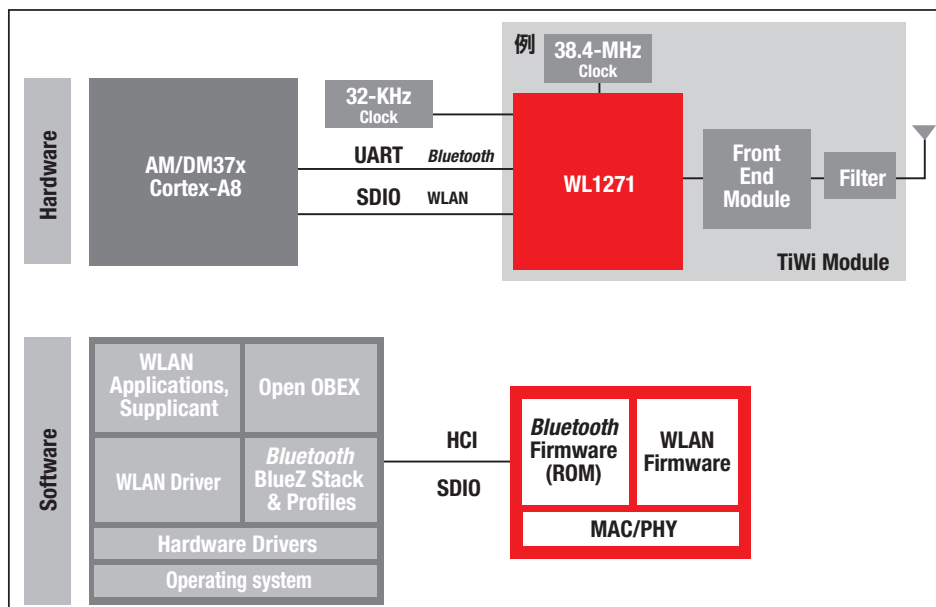
主な特長

WL1271-TiWi

- IEEE 802.11 b/g/n 準拠
- WLAN 送信電力 (typ):
 - 11Mbps, CCK(b): +20dBm
 - 54Mbps, OFDM(g): +14.5dBm
 - 65Mbps, OFDM(n): +12.5dBm
- WLAN受信感度 (typ):
 - 11Mbps: -89dBm
 - 54Mbps: -76dBm
 - 65Mbps: -73dBm
- Bluetooth v2.1+EDR
 - Bluetooth送信電力を向上: +9.5dBm
 - 受信感度: -92dBm
- クラス最高のco-existence (同時動作) テクノロジーをワンチップに統合
- Enhanced Low Power (ELP) テクノロジー
- TCXO、パワーレギュレーションおよびU.FLアンテナ・コネクタをオンボードに実装
- ANTおよびBLE (Bluetooth Low Energy) はソフトウェアアップグレードで対応
- FCC/IC/CE の認証を取得済
- WL1271-TiWiモジュール・サイズ: 13mm×18mm×1.9mm

AM/DM37x ARM Cortex-A8

- 最高1GHzで動作するCortex-A8プロセッサおよびNEON™コープロセッサ
- 3Dグラフィックス・アクセラレータ (3715)
- オンチップの64KB SRAM
- LPDDRおよびNANDインターフェイス
- USB HS Host×3、2.0 OTG
- MMC/SDカード・インターフェイスを3本搭載



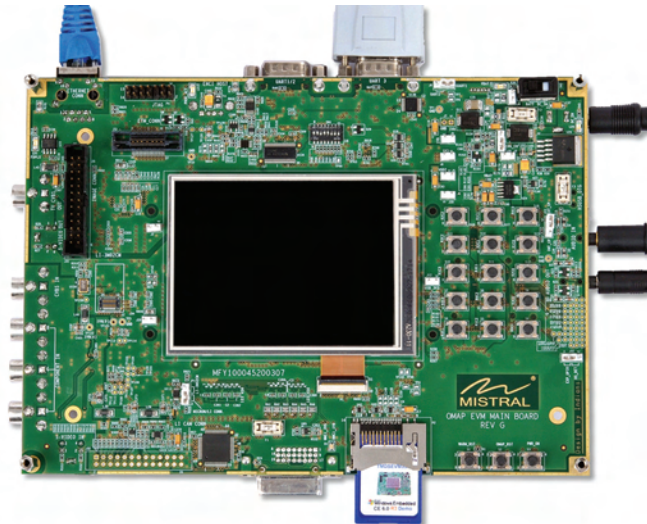
▲ WL1271-TiWi WLANおよびBluetoothシステム

ハードウェアおよびソフトウェア用の開発ツール

WL1271+AM/DM37xプラットフォーム

ハードウェア

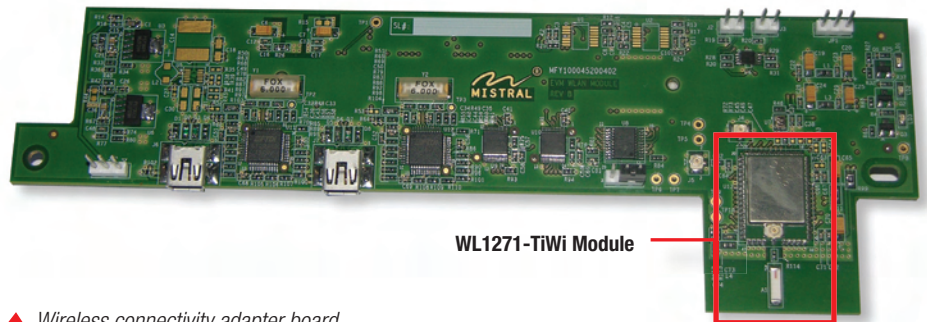
- AM/DM37x EVM :
 - 1GHz ARM Cortex™-A8プロセッサ
 - 256 MB MDDR/512 MB NAND
 - TPS64102 パワー・マネージメント・モジュール
 - 3.7 LCD タッチ・スクリーン
 - ペリフェラルへのアクセス
- ワイヤレス・コネクティビティ・アダプターボード
 - TCXOを統合したWL1271-TiWi モジュール
 - 2.4GHzチップ・アンテナまたはU.FLアンテナ・コネクタ
 - EVMの拡張コネクタにプラグインで接続



ソフトウェア

- ユーザー・インターフェイスおよびデモンストレーションとともに、TIのLinux SDK (ソフトウェア開発キット)に統合、検証済
- WLANおよびBluetoothソフトウェアをサポート
- Wi-FiおよびBluetoothの仕様への適合を試験済のコアIP
- オープン・ソースのLinuxドライバ群 : Kernel 2.6.x, TI WLANドライバ、BlueZ Bluetoothスタック
- ユーザー・ガイド、コンプリートなAPIリファレンス、アプリケーション・ノート、デモンストレーション・アプリケーションおよびサンプル・コード

▲ TMDXEVM3730: AM/DM37x Evaluation module



WL1271-TiWi Module

▲ Wireless connectivity adapter board

プラットフォーム・リソース

- TIの技術者への質問受付先 : <http://e2e.ti.com/forums>
- TIのコネクティビティ ウィキペディア : www.ti.com/connectivitywiki

プラットフォーム・パートナー各社

- Linuxシステムの統合 : Mistral
 <http://www.mistralsolutions.com>
- ハードウェアおよびアンテナ設計 : LS Research
 <http://www.lsr.com>
- Win CEシステムの統合 : Adeneo
 <http://www.adeneo-embedded.com>

ご注意 : 本資料に記載された製品・サービスにつきましては予告なしにご提供の中止または仕様の変更をすることがありますので、本資料に記載された情報が最新のものであることをご確認の上ご注文下さいますようお願い致します。
TIは製品の使用用途に関する援助、お客様の製品もしくはその設計、ソフトウェアの性能、または特許侵害に対して責任を負うものではありません。また、他社の製品・サービスに関する情報を記載していても、TIがその他社製品を承認あるいは保証することにはなりません。

Platform barおよびMSP430はTexas Instrumentsの登録商標です。BluetoothのワードマークおよびロゴはBluetooth Sig, Inc.が所有し、使用許諾済です。
すべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。

S-0107

ご注意

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社（以下TIJといいます）及びTexas Instruments Incorporated (TIJの親会社、以下TIJないしTexas Instruments Incorporatedを総称してTIといいます）は、その製品及びサービスを任意に修正し、改善、改良、その他の変更をし、もしくは製品の製造中止またはサービスの提供を中止する権利を留保します。従いまして、お客様は、発注される前に、関連する最新の情報を取得して頂き、その情報が現在有効かつ完全なものであるかどうかご確認下さい。全ての製品は、お客様とTIJとの間に取り引契約が締結されている場合は、当該契約条件に基づき、また当該取引契約が締結されていない場合は、ご注文の受諾の際に提示されるTIJの標準販売契約約款に従って販売されます。

TIは、そのハードウェア製品が、TIの標準保証条件に従い販売時の仕様に対応した性能を有していること、またはお客様とTIJとの間で合意された保証条件に従い合意された仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査およびその他の品質管理技法は、TIが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行なわれております。各デバイスの全てのパラメーターに関する固有の検査は、政府がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。

TIは、製品のアプリケーションに関する支援もしくはお客様の製品の設計について責任を負うことはありません。TI製部品を使用しているお客様の製品及びそのアプリケーションについての責任はお客様にあります。TI製部品を使用したお客様の製品及びアプリケーションについて想定されうる危険を最小のものとするため、適切な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。

TIは、TIの製品もしくはサービスが使用されている組み合わせ、機械装置、もしくは方法に関連しているTIの特許権、著作権、回路配置利用権、その他のTIの知的財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾するということは明示的にも黙示的にも保証も表明もしておりません。TIが第三者の製品もしくはサービスについて情報を提供することは、TIが当該製品もしくはサービスを使用することについてライセンスを与えとか、保証もしくは是認するということを意味しません。そのような情報を使用するには第三者の特許その他の知的財産権に基づき当該第三者からライセンスを得なければならない場合もあり、またTIの特許その他の知的財産権に基づきTI からライセンスを得て頂かなければならない場合もあります。

TIのデータ・ブックもしくはデータ・シートの中にある情報を複製することは、その情報に一切の変更を加えること無く、かつその情報と結び付けられた全ての保証、条件、制限及び通知と共に複製がなされる限りにおいて許されるものとします。当該情報に変更を加えて複製することは不公正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような変更された情報や複製については何の義務も責任も負いません。

TIの製品もしくはサービスについてTIにより示された数値、特性、条件その他のパラメーターと異なる、あるいは、それを超えてなされた説明で当該TI製品もしくはサービスを再販売することは、当該TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的保証、及び何らかの黙示的保証を無効にし、かつ不公正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような説明については何の義務も責任もありません。

TIは、TIの製品が、安全でないことが致命的となる用途ないしアプリケーション（例えば、生命維持装置のように、TI製品に不良があった場合に、その不良により相当な確率で死傷等の重篤な事故が発生するようなもの）に使用されることを認めておりません。但し、お客様とTIの双方の権限有る役員が書面でそのような使用について明確に合意した場合は除きます。たとえTIがアプリケーションに関連した情報やサポートを提供したとしても、お客様は、そのようなアプリケーションの安全面及び規制面から見た諸問題を解決するために必要とされる専門的知識及び技術を持ち、かつ、お客様の製品について、またTI製品をそのような安全でないことが致命的となる用途に使用することについて、お客様が全ての法的責任、規制を遵守する責任、及び安全に関する要求事項を満足させる責任を負っていることを認め、かつそのことに同意します。さらに、もし万一、TIの製品がそのような安全でないことが致命的となる用途に使用されたことによって損害が発生し、TIないしその代表者がその損害を賠償した場合は、お客様がTIないしその代表者にその全額の補償をするものとします。

TI製品は、軍事的用途もしくは宇宙航空アプリケーションないし軍事的環境、航空宇宙環境にて使用されるようには設計もされていませんし、使用されることを意図されておられません。但し、当該TI製品が、軍需対応グレード品、若しくは「強化プラスチック」製品としてTIが特別に指定した製品である場合は除きます。TIが軍需対応グレード品として指定した製品のみが軍需品の仕様書に合致いたします。お客様は、TIが軍需対応グレード品として指定していない製品を、軍事的用途もしくは軍事的環境下で使用することは、もっぱらお客様の危険負担においてなされるということ、及び、お客様がもっぱら責任をもって、そのような使用に関して必要とされる全ての法的要求事項及び規制上の要求事項を満足させなければならないことを認め、かつ同意します。

TI製品は、自動車用アプリケーションないし自動車の環境において使用されるようには設計されていませんし、また使用されることを意図されておられません。但し、TIがISO/TS 16949の要求事項を満たしていると特別に指定したTI製品は除きます。お客様は、お客様が当該TI指定品以外のTI製品を自動車用アプリケーションに使用しても、TIは当該要求事項を満たしていなかったことについて、いかなる責任も負わないことを認め、かつ同意します。

Copyright © 2012, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

弊社半導体製品の取り扱い・保管について

半導体製品は、取り扱い、保管・輸送環境、基板実装条件によっては、お客様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。

1. 静電気
 - 素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。
 - 弊社出荷梱包単位（外装から取り出された内装及び個装）又は製品単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で（導電性マットにアースをとったもの等）、アースをした作業者が行うこと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。
 - マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。
 - 前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認されていること。
2. 温・湿度環境
 - 温度：0～40℃、相対湿度：40～85％で保管・輸送及び取り扱いを行うこと。（但し、結露しないこと。）

- 直射日光があたる状態で保管・輸送しないこと。
3. 防湿梱包
 - 防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装すること。
 4. 機械的衝撃
 - 梱包品（外装、内装、個装）及び製品単品を落下させたり、衝撃を与えないこと。
 5. 熱衝撃
 - はんだ付け時は、最低限260℃以上の高温状態に、10秒以上さらさないこと。（個別推奨条件がある時はそれに従うこと。）
 6. 汚染
 - はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚染物質（硫黄、塩素等ハロゲン）のある環境で保管・輸送しないこと。
 - はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。（不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。）

以上